

半导体

 证券研究报告
 2025年08月25日

3 季度半导体景气度展望乐观，持续重点关注国产算力及自主可控方向

投资评级
行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者
潘暕 分析师
 SAC 执业证书编号 : S1110517070005
 panjian@tfzq.com
李泓依 分析师
 SAC 执业证书编号 : S1110524040006
 lihongyi@tfzq.com
骆奕扬 分析师
 SAC 执业证书编号 : S1110521050001
 luoyiyang@tfzq.com
程如莹 分析师
 SAC 执业证书编号 : S1110521110002
 chengruiying@tfzq.com

DeepSeek 发布 V3.1 模型,针对国产芯片适配,模型芯片协同催化产业拐点。DeepSeek 在其官宣布 DeepSeek-V3.1 的文章中提到, DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。DeepSeek 方面表示, UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的。另外, V3.1 对分词器及 chat template 进行了较大调整,与 DeepSeek-V3 存在明显差异。国产开源大模型不断迭代升级,并与国产芯片进行深度适配。此次 DeepSeek V3.1 针对国产新一代芯片优化,不仅体现了国产算力与国产模型的协同效应,也有助于完善本土算力生态。在推理算力和 AI 应用需求持续增长的背景下,国产模型与国产硬件的联动有望加速产业自主可控进程。

英伟达 H20 芯片的销售计划可能出现新的变动,这一动态也进一步凸显出建立自主算力芯片供应链的长期重要性。据路透社与《The Information》等媒体报道,英伟达已通知部分供应商暂停生产专供中国市场的 AI 芯片 H20 相关组件。与此同时,该公司正基于其新一代 Blackwell 架构,为中国市场开发一款新型人工智能芯片,据称其性能将显著超越 H20。

半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。在中美国绕 AI 算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下,预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇,建议重点关注以下细分方向。**建议关注:【芯片设计 ASIC/GPU】:寒武纪、海光信息、芯原股份、翱捷科技、东芯股份。【代工封测】:中芯国际、华虹、甬矽电子、伟测科技。**

Meta 发布会在即,海内外大厂 AI 眼镜齐发,持续重点推荐 AI SoC 及存储环节。Meta Connect 发布会将于 9/17 举办, AI 眼镜出货量有望大超预期。根据 Counterpoint 数据, 25H1 全球智能眼镜市场出货量同比增长高达 110%。2025 年下半年起,市场将迎来更多 AI 智慧眼镜新品,新品持续推出有望带动整体 AI 眼镜需求持续提升。海内外大厂持续重点布局 AI 眼镜, Meta 作为产业先行者,公司预计将有重大可穿戴设备发布,随着新品推出有望带动智能眼镜需求持续增长。谷歌 Pixel 10 系列智能手机发布,并推出了首款完全自主设计的 Tensor G5,该芯片彻底摆脱了以往基于三星 Exynos 架构修改的模式,采用台积电 3nm 制程工艺制造。Tensor G5 实现了显著的性能提升, CPU 性能提高 36%,专用于 AI 处理的 TPU 性能更大提升 60%。这款芯片旨在支撑 Pixel 设备端侧运行更复杂的 Gemini 模型,支持包括智能情景提示 (Magic Cue)、实时拍摄指导 (Camera Coach) 等功能,增强本地化 AI 体验,成为谷歌推动端侧 AI 战略的核心硬件基石。**建议关注:【AI SOC】AI 新品齐发,算力落地量价齐升:恒玄科技、星辰科技、炬芯科技、瑞芯微、乐鑫科技、晶晨股份、全志科技、中科蓝讯等。【存储/其他】适配算力,需求与技术双轮驱动:江波龙、佰维存储、兆易创新、润欣科技等。**

半导体行业 7 月景气度总结及 3 季度展望,行情延续景气。交期价格方面:7 月主要芯片厂商交期有所上升,存储、模拟、功率、被动器件产品价格回升。DDR4 为代表存储价格持续波动;模拟、功率、被动器件交期保持稳定,部分价格有回升;MCU 交期稳定。展望 Q3,整体交期或有上升,价格延续稳定上升,分销环节订单持续改善。7 月半导体供应链:总结来看,设备和材料增长稳定,晶圆代工产能持续上升,原厂订单改善,封测端订单增长良好。**硅晶圆/设备:**半导体设备持续增长,材料厂商订单持续改善。**晶圆代工:**代工订单持续复苏。**封装测试:**订单增长良好。

综合来看 2025 年,全球半导体增长延续乐观增长走势,2025 年 AI 驱下游增长。同时,政策对供应链中断与重构风险持续升级,国产替代持续推进。二季度各一环节公司业绩预告亮眼,展望三季度半导体旺季,建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS 业绩弹性。设备材料零部件算力芯片国产替代。存储板块预估 3Q25 存储器合约价涨幅持续高增,企业级产品持续推进,带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价,2-3 季度业绩展望乐观,先进制程的边际变化持续催化。端侧 AI SoC 芯片公司受益于端侧 AI 硬件渗透率释放,一二季度业绩已体现高增长,叠加 2 季度末 3 季度初 AI 眼镜密集发布,后续展望乐观。ASIC 公司收入增速逐步体现,Deepseek 入局助力快速发展。CIS 受益智能车需求及龙头手机新品发布带动需求迭升。模拟板块市场复苏信号已现,2 季度业绩增速喜人。设备材料板块,国产光刻机推进速度持续加快,产业后续或将存在重大催化。其他核心设备方面头部厂商 2025Q1 及部分 Q2 业绩预告表现亮眼,同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合,助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。

建议关注

算力芯片及 ASIC: 寒武纪/海光信息/翱捷科技/芯原股份

半导体存储: 江波龙(天风计算机联合覆盖)/香农芯创/德明利/佰维存储/朗科科技/联芸科技/兆易创新/北京君正/普冉股份/东芯股份/恒烁股份/澜起科技/聚辰股份/深科技/太极实业/万润科技

IDM 代工封测: 华虹半导体/中芯国际/伟测科技/甬矽电子/长电科技/通富微电/华天科技/扬杰科技/闻泰科技/三安光电/利扬芯片

SoC 及配套方案商: 恒玄科技/泰凌微/星辰科技/瑞芯微/晶晨股份/全志科技/乐鑫科技/中科蓝讯/润欣科技/炬芯科技/富瀚微

半导体材料设备零部件: 北方华创/精智达/冠石科技/京仪装备/格林达/百微化学/雅克科技/鼎龙股份(天风化工联合覆盖)/天岳先进/和远气体/正帆科技(天风机械联合覆盖)/中微公司/拓荆科技/富创精密/精智达/沪硅产业/上海新阳/安集科技/盛美上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/凯美特气/金海通(天风机械联合覆盖)/鸿日达/精测电子/国力股份/新莱应材/长川科技(天风机械覆盖)/联动科技/茂莱光学/艾森股份/江丰电子

光刻机产业链: 茂莱光学/汇成真空/波光光电/福晶科技/福光股份

其他设计: 圣邦股份/纳芯微/南芯科技/雅创电子/卓胜微/思瑞浦/杰华特/芯朋微/帝奥微/晶丰明源/艾为电子/唯捷创芯/龙芯中科/海光信息(天风计算机覆盖)/龙迅股份/芯恩/天德钰/汇顶科技/思特威/扬杰科技/复旦微电/铨泉科技/力合微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/民德电子/新洁能/韦尔股份/希荻微/安路科技

光子芯片: 迈信林/源杰科技(通信组联合覆盖)/长光华芯/仕佳光子/杰普特/炬光科技

高可靠电子: 盛景微/电科芯片/景嘉微/中润光学/长光华芯/上海复旦/复旦微电

风险提示: 地缘政治带来的不可预测风险,需求复苏不及预期,技术迭代不及预期,产业政策变化风险

行业走势图



资料来源:聚源数据

相关报告

- 《半导体-行业研究周报:“以存代算”开启存储新纪元,7 月半导体行情延续景气》 2025-08-19
- 《半导体-行业研究周报:海外龙头及国产代工最新业绩总结,关注旺季下的涨价、扩产、复苏》 2025-08-12
- 《半导体-行业研究周报:25Q2 半导体持仓总结及 Q3 景气度展望,关注旺季

内容目录

1. 3 季度半导体景气度展望乐观，持续重点关注国产算力及自主可控方向.....	5
1.1. DeepSeek-V3.1 正式发布，模型芯片协同催化产业拐点.....	6
1.2. 英伟达停产 H20 芯片，重点关注国内算力芯片自主供应机会	6
1.3. Meta 发布会在即，海内外大厂 AI 眼镜齐发，持续推荐 AI SOC 及存储	7
1.4. Google Pixel 10 发布：自研芯片+端侧模型	8
2. 7 月半导体产业宏观数据：半导体增长持续，中美市场是核心.....	9
3. 2025 年 7 月芯片交期及库存：整体芯片交期趋稳.....	11
4. 2025 年 7 月产业链各环节景气度：	16
4.1. 代工封测：代工订单持续复苏，封测订单增长良好	16
4.2. 设备材料零部件：国产自主可控预计进一步加速，设备厂商等 Q2 签单趋势向好	17
4.2.1. 设备及零部件中标情况：2025 年 7 月可统计中标设备数量共计 12 台.....	17
4.2.2. 设备招标情况：2025 年 7 月可统计招标设备 1 台.....	20
4.3. 分销商：2025 年中国分销市场预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场采购和布局.....	22
5. 7 月终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势.....	22
5.1. 消费电子：无人机商业化应用加速，传音拟非洲等布局电动两轮车业务	22
5.2. 新能源汽车：特斯拉销量下滑明显，市场竞争加剧	22
5.3. 工控：数据中心和电气化相关订单增长强劲，欧洲工业市场需求相对疲软.....	23
5.4. 光伏：头部厂商上半年亏损明显，预计今年全球光伏需求保持稳定，但增速有所放缓	23
5.5. 储能：储能订单增长预期良好，国内厂商加速海外市场布局.....	24
5.6. 数据中心：云计算厂商投入持续，上游服务器订单增长强劲.....	24
5.7. 通信：传统网络通信业务仍疲软，数据中心相关订单强劲	24
5.8. 医疗器械：头部厂商中国市场订单低迷，Q3 或迎来拐点	24
6. 存储行情：本周存储现货市场以持稳为主，行业 DDR4 内存条与 LPDDR4X 产品高位盘整.....	25
7. 上周（08/18-08/22）半导体行情回顾.....	28
8. 上周（08/18-08/22）重点公司公告.....	29
9. 上周（08/18-08/22）半导体重点新闻.....	29
10. 风险提示.....	30

图表目录

图 1：编程智能体测评.....	6
图 2：国家互联网信息办公室约谈英伟达公司.....	7
图 3：Meta Celeste 眼镜前框.....	8
图 4：谷歌 Tensor G5 芯片	9
图 5：全球半导体销售额走势（十亿美金，%）	10
图 6：中国集成电路产量（万块）	10

图 7: 中国半导体 (SW) 行业指数	10
图 8: 费城半导体指数 (SOX)	10
图 9: 电子 (申万) 各板块涨跌幅 (2025 年 7 月)	11
图 10: 电子 (申万) 各板块涨跌幅 (2024 年 1-12 月)	11
图 11: 全球芯片平均交货周期 (周)	11
图 12: 头部厂商 2025 年 7 月订单及库存	16
图 13: 主要晶圆代工厂动态	16
图 14: 主要封测厂商动态	16
图 15: 半导体设备及硅晶圆头部企业情况	17
图 16: 2025 年 7 月部分国内企业可统计中标情况 (台)	17
图 17: 2020-2025.7 北方华创可统计中标情况 (台)	17
图 18: 2025 年 1-6 月北方华创各主要设备类型中标分布情况 (台)	18
图 19: 2024 年 1-12 月北方华创各主要设备类型中标分布情况 (台)	18
图 20: 2011-2025.7 国内半导体设备零部件可统计中标情况 (台)	19
图 21: 2011-2025.7 国外半导体设备零部件可统计中标情况 (台)	20
图 22: 2020-2025.7 华虹宏力可统计招标情况 (台)	21
图 23: 2025 年 1-6 月华虹宏力各主要设备类型招标分布情况 (台)	21
图 24: 2024 年 1-12 月华虹宏力各主要设备类型招标分布情况 (台)	21
图 25: 主要元器件分销商最新动态	22
图 26: 消费电子厂商最新动态	22
图 27: 新能源汽车厂商最新动态	22
图 28: 工控厂商最新动态	23
图 29: 光伏厂商最新动态	23
图 30: 存储厂商最新动态	24
图 31: 数据中心厂商最新动态	24
图 32: 通信厂商最新动态	24
图 33: 医疗器械厂商最新动态	25
图 34: NAND 指数	25
图 35: DRAM 指数	25
图 36: Flash Wafer 8.19 报价 (美元)	26
图 37: DDR 8.19 报价 (美元)	26
图 38: 渠道市场 SSD 8.19 报价 (美元)	26
图 39: 渠道市场内存条 8.19 报价 (美元)	26
图 40: 行业市场 SSD 7.22 报价 (美元)	26
图 41: 行业市场内存条 7.22 报价 (美元)	26
图 42: eMMC 8.18 报价 (美元)	27
图 43: eMCP 8.18 报价 (美元)	27
图 44: LPDDR 8.19 报价 (美元)	27
图 45: UFS 8.19 报价 (美元)	27
图 46: uMCP 8.19 报价 (美元)	28
图 47: 上周 A 股各行业行情对比 (%)	28

图 48：上周子板块涨跌幅（%）	28
表 1：头部厂商 2025 年 7 月交期及趋势	12
表 2：上周半导体行情与主要指数对比	28

1.3 季度半导体景气度展望乐观，持续重点关注国产算力及自主可控方向

DeepSeek 发布 V3.1 模型，针对国产芯片适配，模型芯片协同催化产业拐点。 DeepSeek 在其官宣布 DeepSeek-V3.1 的文章中提到，DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。DeepSeek 方面表示，UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的。另外，V3.1 对分词器及 chat template 进行了较大调整，与 DeepSeek-V3 存在明显差异。国产开源大模型不断迭代升级，并与国产芯片进行深度适配。此次 DeepSeek V3.1 针对国产新一代芯片优化，不仅体现了国产算力与国产模型的协同效应，也有助于完善本土算力生态。在推理算力和 AI 应用需求持续增长的背景下，国产模型与国产硬件的联动有望加速产业自主可控进程。

英伟达 H20 芯片的销售计划可能出现新的变动，这一动态也进一步凸显出建立自主算力芯片供应链的长期重要性。 据路透社与《The Information》等媒体报道，英伟达已通知部分供应商暂停生产专供中国市场的 AI 芯片 H20 相关组件。与此同时，该公司正基于其新一代 Blackwell 架构，为中国市场开发一款新型人工智能芯片，据称其性能将显著超越 H20。

半导体、国产算力及自主可控等领域仍将是未来的长期趋势。 在中美国围绕 AI 算力芯片的贸易政策持续存在不确定性的背景下，预计国内大模型开发企业与互联网平台将逐步提高国产芯片的采购与使用规模。相应的国产芯片供应商及其配套产业链企业有望迎来发展机遇，建议重点关注以下细分方向。**建议关注：【芯片设计 ASIC/GPU】：寒武纪、海光信息、芯原股份、翱捷科技、东芯股份。【代工封测】：中芯国际、华虹、甬矽电子、伟测科技。**

Meta 发布会在即，海内外大厂 AI 眼镜齐发，持续重点推荐 AI SoC 及存储环节。 Meta Connect 发布会将于 9/17 举办，AI 眼镜出货量有望大超预期。根据 Counterpoint 数据，25H1 全球智能眼镜市场出货量同比增长高达 110%。2025 年下半年起，市场将迎来更多 AI 智慧眼镜新品，新品持续推出有望带动整体 AI 眼镜需求持续提升。海内外大厂持续重点布局 AI 眼镜，Meta 作为产业先行者，公司预计将有重大可穿戴设备发布，随着新品推出有望带动智能眼镜需求持续增长。**谷歌 Pixel 10 系列智能手机发布，并推出了首款完全自主设计的 Tensor G5，该芯片彻底摆脱了以往基于三星 Exynos 架构修改的模式，采用台积电 3nm 制程工艺制造。** Tensor G5 实现了显著的性能提升，CPU 性能提高 36%，专用于 AI 处理的 TPU 性能更大幅提升 60%。这款芯片旨在支撑 Pixel 设备端侧运行更复杂的 Gemini 模型，支持包括智能情景提示（Magic Cue）、实时拍摄指导（Camera Coach）等功能，**增强本地化 AI 体验，成为谷歌推动端侧 AI 战略的核心硬件基石。建议关注：【AI SOC】AI 新品齐发，算力落地量价齐升：恒玄科技、星辰科技、炬芯科技、瑞芯微、乐鑫科技、晶晨股份、全志科技、中科蓝讯等。【存储/其他】适配算力，需求与技术双轮驱动：江波龙、佰维存储、兆易创新、润欣科技等。**

半导体行业 7 月景气度总结及 3 季度展望，行情延续景气：交期价格方面：7 月主要芯片厂商交期有所上升，存储、模拟、功率、被动器件产品价格回升。DDR4 为代表存储价格持续波动；模拟、功率、被动器件交期保持稳定，部分价格有回升；MCU 交期稳定。展望 Q3，整体交期或有上升，价格延续稳定上升，分销环节订单持续改善。**7 月半导体供应链：**总结来看，设备和材料增长稳定，晶圆代工产能持续上升，原厂订单改善，封测端订单增长良好。**硅晶圆/设备：**半导体设备持续增长，材料厂商订单持续改善。**晶圆代工：**代工订单持续复苏。**封装测试：**订单增长良好。

综合来看 2025 年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025 年 AI 驱下游增长。 同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS 业绩弹性，设备材料零部件算力芯片国产替代。存储板块预估 3Q25 存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3 季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化。端侧 AI SoC 芯片公司受益于端侧 AI 硬件渗透率释放，一二季度业绩已体现高增长，叠加 2 季度末 3 季度初 AI 眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC 公司收入增速逐步体现，Deepseek 入局助力快速发展。CIS 受益智能车需求及龙头手机新品发布带动需求迭升。模拟板块市场复苏信号已现，2 季度业绩增速喜人。设备材料板块，国产光刻机推进速度持续加快，产业后续或将存在重大催化。其他

核心设备方面头部厂商 2025Q1 及部分 Q2 业绩预告表现亮眼，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。

1.1. DeepSeek-V3.1 正式发布，模型芯片协同催化产业拐点

8月21日消息，DeepSeek 正式发布了 DeepSeek v3.1 版，本次升级包含以下主要变化：

- **混合推理架构**：一个模型同时支持思考模式与非思考模式；
- **更高的思考效率**：相比 DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think 能在更短时间内给出答案；
- **更强的 Agent 能力**：通过 Post-Training 优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。

图 1：编程智能体测评

Benchmarks	DeepSeek-V3.1	DeepSeek-V3-0324	DeepSeek-R1-0528
SWE-bench Verified	66.0	45.4	44.6
SWE-bench Multilingual	54.5	29.3	30.5
Terminal-Bench	31.3	13.3	5.7

资料来源：DeepSeek 公众号，天风证券研究所 注：SWE 使用内部框架测评，相比开源框架 OpenHands 所需轮数更少；Terminal Bench 使用官方 Terminus 1 framework

根据电子发烧友公众号，V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 技术，将参数精度提升至 8 位浮点数规模。这一设计不仅减少 30% 的内存占用，更通过量化感知训练保持模型精度。DeepSeek 官方透露，UE8M0 FP8 标准是专为下一代国产芯片设计的计算范式，可显著提升芯片在 AI 推理场景下的能效比。FP8 是 Float8 的简称，即用 8 位二进制数表示浮点数，主要用于深度学习的训练和推理。相比传统的 FP32（32 位浮点数）或 FP16（16 位浮点数），FP8 显著降低了显存占用和计算资源需求，同时通过优化设计（如动态范围调整）维持了较高的精度。FP8 对国产芯片的使用效率提升显著，将进一步缩小与 NVIDIA 芯片的效率/成本差距，大大增加国产芯片的可用性。

建议关注

受益核心标的：存力升级+算力解放双主线机会

- ▶ **芯片设计 ASIC/GPU**：寒武纪、海光信息、芯原股份、翱捷科技、东芯股份
- ▶ **AI 存储**：江波龙、兆易创新、德明利、佰维存储

风险提示：AI 芯片流片进度滞后、超算中心建设不及预期、技术路线迭代风险

1.2. 英伟达停产 H20 芯片，重点关注国内算力芯片自主供应机会

8月22日，The information 消息，英伟达已通知部分零部件供应商，暂停中国特供 AI 芯片 H20 的生产。

H20 是英伟达为遵守美国出口限制而推出，专为中国市场设计的 AI 芯片，占英伟达中国区收入的 80%。今年 4 月，美国禁止英伟达向中国销售 H20。直到 7 月中旬，黄仁勋才宣

布将恢复销售。7月29日，路透社报道，中国市场需求比预想中强劲，英伟达上周不得不改变仅依赖现有库存的策略，向台积电紧急订购了30万片H20。8月，H20正式获得对华出口许可，但条件是向美国政府上缴15%的销售额。不过在7月31日，网信中国公众号发文，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。

央视新闻同样提到，此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为此，国家互联网信息办公室约谈了英伟达公司，要求英伟达针对H20漏洞后门安全风险问题，进行说明并提交相关证明材料。对此，英伟达深夜回应：“网络安全对我们至关重要。NVIDIA的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”

图 2：国家互联网信息办公室约谈英伟达公司

国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司

网信中国 2025年07月31日 13:00 北京

 点击“网信中国”关注官方账号

近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

资料来源：科技每日推送公众号，天风证券研究所

当地时间8月19日，2名英伟达方面的知情人士向路透社爆料称，该公司正在为中国市场开发一款基于其最新Blackwell架构的新型人工智能芯片，并宣称其性能将比H20更强大。

相关消息称，新款芯片暂定名为B30A，将采用单芯片(single-die)设计，其原始计算能力可能仅为英伟达旗舰产品B300芯片的一半，预计将配备高带宽内存以及英伟达的NVLink技术。英伟达方面已计划最早于下个月向中国客户交付样品并进行测试。

也有观点认为，英伟达此次停产H20芯片，或是为其新产品B30A让路。但分析指出，在英伟达解决其在中国市场销售的AI芯片存在“安全”问题的疑虑之前，具有国资背景企业或与官方有合作的私企都不会贸然采购其产品。

建议关注：【芯片设计 ASIC/GPU】：寒武纪、海光信息、芯原股份、翱捷科技、东芯股份。【AI 存储】：江波龙、兆易创新、德明利、佰维存储。【代工封测】：中芯国际、华虹、甬矽电子、伟测科技

1.3. Meta 发布会在即，海内外大厂 AI 眼镜齐发，持续推荐 AI SOC 及存储

Meta Connect 将于2025年9月17日-18日举办，公司称预计将有“重大可穿戴设备发布”和“元宇宙软件突破”。年初扎克伯格喊出“2025是AI眼镜决胜之年”，全球约有30款AI眼镜发布。

核心硬件看点包括：(1) 定位高端、售价千元级的单眼带屏智能眼镜 Meta Celeste (代号 Hypernova)，根据已知信息，Meta Celeste 的核心亮点之一就是其独特的单目全彩显示屏，采用的是 Lcos+ 全彩阵列光波导。该显示屏位于右镜片的右下角区域，用于显示时间、天气、通知、导航翻译、照片预览及 Meta AI 文本回复 (非语音)，Meta Celeste 还有一款配套的腕带控制器，代号为“Ceres”。该设备采用肌电 (EMG) 技术，可以使用手势来控制眼

镜，转转手、捏捏手指来滚动和选取项目；（2）**Ray-Ban Meta 第三代产品推出近视镜架和飞行员墨镜款**，据业内爆料，Meta 会在今年九月正式发布两款新的 RayBan-Meta 产品，代号分别为两款鸡尾酒名称，Aperol 和 Bellini。其中，代号为 Bellini 的产品，正式上市名称为 RayBan Meta 3 Optical，主打的是近视镜架款。而代号为 Aperol 的产品则为 Ray-Ban Meta 3，产品形态为飞行员款，依然为墨镜款；（3）**更专业的运动 AI 眼镜 Oakley Meta Sphaera**：该产品基于 Oakley Sphaera 运动眼镜框架开发，搭载 PRIZM Lens 光学技术，配备 1200 万像素超广角摄像头支持 3K 视频拍摄，并具备 IPX4 防水等级及开放式耳罩式扬，这款产品定位运动场景，针对骑行、跑步等户外运动设计，集成 Meta AI 交互功能与实时天气预警、AR 导航等核心功能；与 Prada 的联名则聚焦高奢市场。此外，台媒爆料 Meta 正与国内代工厂商华勤合作，计划开发搭载摄像头的智能手表，相应手表据称可以与 Quest 等 XR 头显及后续 Meta AR 眼镜联动使用，进一步扩展 Meta 的“元宇宙”愿景。

软件层面：Meta 为其社交平台 Horizon Worlds 桌面编辑器发布了新的生成式 AI 功能，包括两个主要工具：“创作者助手”和“风格参考”，将加速和简化创作者的世界构建过程；Meta 宣布将其 Quest 软件平台更名为 Meta Horizon OS，旨在为开发者打造一个更开放的生态系统；Meta 或准备最终推出其长期研发的 Codec Avatars 技术。该技术旨在提供社交临场感。据目前的消息推测，Meta 可能会先推出具有 AI 模拟面部追踪功能的 Codec Avatars 的初级平板版本，能让用户以比 Meta Avatar 更逼真的形式进行 WhatsApp 和 Messenger 视频通话。总体来看，Meta 首先在硬件上用 Celeste（带屏 AI 眼镜）过渡真 AR 眼镜，规避 Orion 因材料成本超万美元的量产困境；其次则是交互革命：以肌电腕带取代手柄，解决 AR 场景操控痛点，建立技术壁垒；最后是生态开发降门槛：通过更开放和更先进的元宇宙开发软件，将元宇宙创作成本进一步降低。

图 3：Meta Celeste 眼镜前框



资料来源：VR 陀螺公众号，天风证券研究所

建议关注：

【AI SOC】AI 新品齐发，算力落地量价齐升：恒玄科技、星辰科技、炬芯科技、瑞芯微、乐鑫科技、晶晨股份、全志科技、中科蓝讯等。

【存储/其他】适配算力，需求与技术双轮驱动：江波龙、佰维存储、兆易创新、润欣科技等。

1.4. Google Pixel 10 发布：自研芯片+端侧模型

北京时间 8 月 21 日凌晨，在纽约布鲁克林举行的「Made by Google」年度硬件盛会上，Google 正式揭开了新一年硬件产品线的全新篇章，正式发布了备受瞩目的 Pixel 10 系列智能手机。该款手机搭载谷歌自研 Tensor G5 芯片，标志着谷歌首次推出完全自主设计、摆脱三星 Exynos 架构基础的旗舰处理器，为实现更深度的端侧 AI 体验奠定了硬件基石。

Tensor G5 是谷歌第一款「完全自主设计，没有三星帮助」的处理器，彻底告别了过去四代产品基于三星 Exynos 架构进行修改的模式。这颗由业界顶尖的台积电（TSMC）采用其先进的 3nm 工艺生产的芯片，带来了实打实的性能飞跃：CPU 性能提升高达 36%，而为 AI 运算量身打造的 TPU 速度更是飙升了 60%。

图 4：谷歌 TensorG5 芯片



资料来源：极客公园公众号，天风证券研究所

这颗强大处理核心所驱动的，是全面覆盖、高度智能化的 Gemini 体验系统。该系统不再局限于传统的应答交互模式，而是演进为一种具备情境感知能力的个人辅助平台。

其典型功能包括“Magic Cue”（智能情景提示）。例如，在用户准备拨打航空公司电话时，系统可自动识别并提前呈现相关航班信息；或在聊天应用中收到他人询问地址的请求时，自动调取已保存的民宿预订信息，支持用户快速分享。该功能体现了系统从被动响应向主动服务的能力跃迁。**另一项重要功能“Camera Coach”（拍摄辅助指导）**能够在用户使用相机时，实时分析画面内容，并基于构图、光线与拍摄角度提供专业建议。该功能旨在辅助用户提升拍摄效果，而非替代用户的创作决策。

此外，系统还整合了可实现通话实时语音翻译的“Voice Translate”，以及新一代音频模型“Gemini Live”。据称，该模型能够识别用户情绪并相应调整语音助手的回应语气，进一步提升了人机交互的自然度和适应性。

Tensor G5 芯片不仅是谷歌硬件自主研发之路的里程碑，更是其未来十年 AI 战略的核心驱动力。

建议关注：

【AI SOC】AI 新品齐发，算力落地量价齐升：恒玄科技、星辰科技、炬芯科技、瑞芯微、乐鑫科技、晶晨股份、全志科技、中科蓝讯等。

【存储/其他】适配算力，需求与技术双轮驱动：江波龙、佰维存储、兆易创新、润欣科技等。

2.7 月半导体产业宏观数据：半导体增长持续，中美市场是核心

根据 WSTS 数据，2024 年全球半导体销售额约 6268.7 亿美元，同比增长 19%。WSTS 表示，全球半导体市场正式告别下行周期，步入复苏轨道。中国市场看，SIA 预计 2024 年中国半导体销售额超 1700 亿美元。CSAID（中国半导体行业协会集成电路设计分会）数据显示 2024 年中国芯片设计销售额 6460.4 亿元（约 909.9 亿美元），长三角地区占比超过 50%，上海以 1795 亿元产值位居国内第一。从销售额过亿产值厂商看，2024 年达 731 家，同比增加 106 家，增长 17%。具体的产品品类看，通信芯片和消费类电子芯片份额占总销售额的 68.48%，超过三分之二。总的来看，中国芯片增长保持稳定，但产品处于市场中低端局面尚未改变。

从全球半导体销售额看，2024 年受中美为代表的核心市场增长推动，全球半导体行业复苏强劲，WSTS 最新数据将其增速由此前的 12.5% 上调至 19.0%。从 2025 年全球半导体销售额预测看，主流机构预测在 6%-15.6% 之间，相较于 2024 年放缓明显。

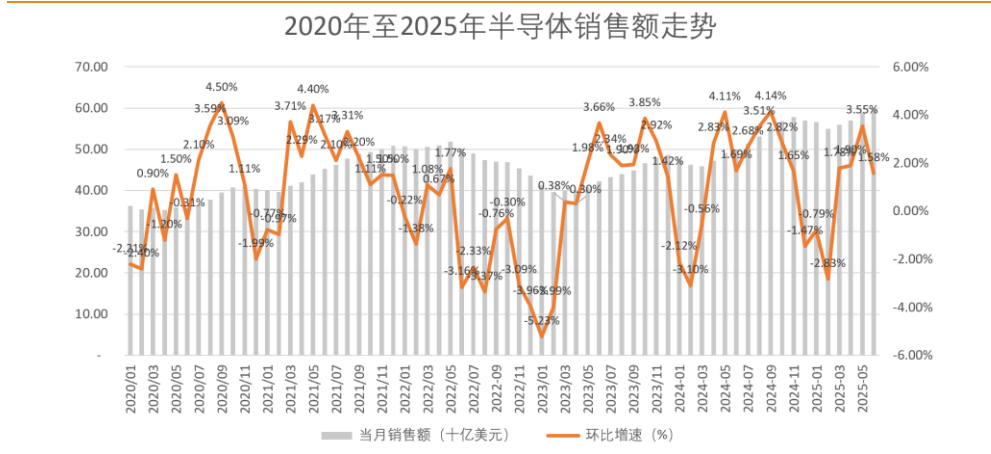
从区域市场看，WSTS 数据显示，2024 年以德国为代表的欧洲市场萎缩较大，同比下滑 6.7%；北美和亚太市场（除日本外）增长强劲，同比增速分别达 38.9%、17.5%。2025 年，

WSTS 预测北美和亚太市场仍是最主要的增量市场，中国和美国增长预期乐观。

细分品类看，WSTS 预计 2025 年增速最快的前三名是逻辑、存储和传感器，分别增长 16.8%、13.4%和 7.0%。相较于 2024 年，存储产品增速回调明显，AI 增长驱动下逻辑芯片增速快速上升。受汽车和工业需求影响，微处理器/控制器、分立器件分别增长 5.6%、5.8%。模拟芯片触底回升明显，同比增长 4.7%。

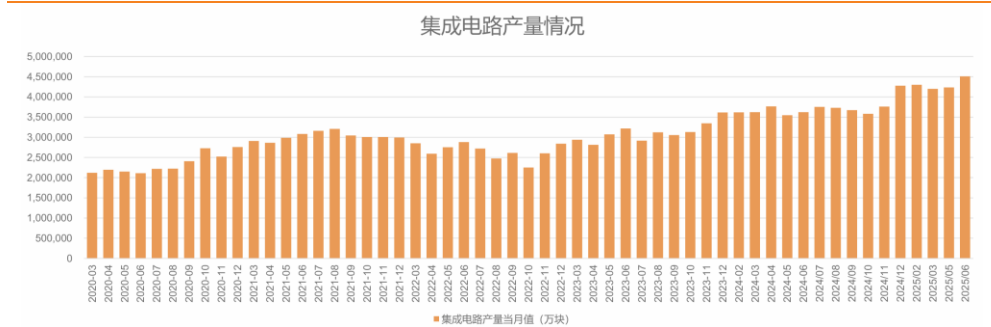
半导体产业宏观数据：根据 SIA 最新数据，2025 年 6 月全球半导体市场销售额为 599.1 亿美元，同比增长 19.6%，连续 14 个月同比增速超 17%，SIA 预计全年增长将出现在下半年。从集成电路产量看，6 月全球集成电路产量约 1291 亿块，同比增长超 15%；中国产量超 450.6 亿块，1-6 月累计 2394.7 亿块，呈现快速增长态势。

图 5：全球半导体销售额走势（十亿美金，%）



资料来源：SIA，芯八哥公众号，天风证券研究所

图 6：中国集成电路产量（万块）



资料来源：芯八哥公众号，工信部等，天风证券研究所

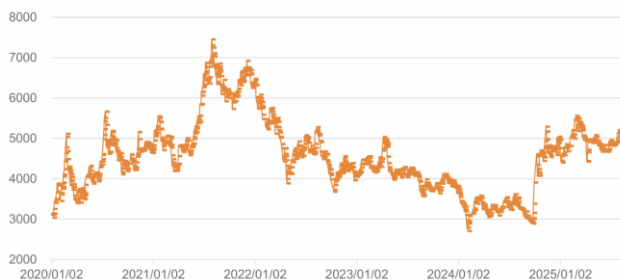
中国半导体指数：7 月，中国半导体 (SW) 业指数上升 3.5%，半导体资本市场景气度回升。

全球半导体指数：7 月，费城半导体指数 (SOX) 上涨 1.8%。

图 7：中国半导体 (sw) 行业指数

图 8：费城半导体指数 (sox)

申万行业指数:半导体



资料来源: iFinD, 天风证券研究所

费城半导体指数

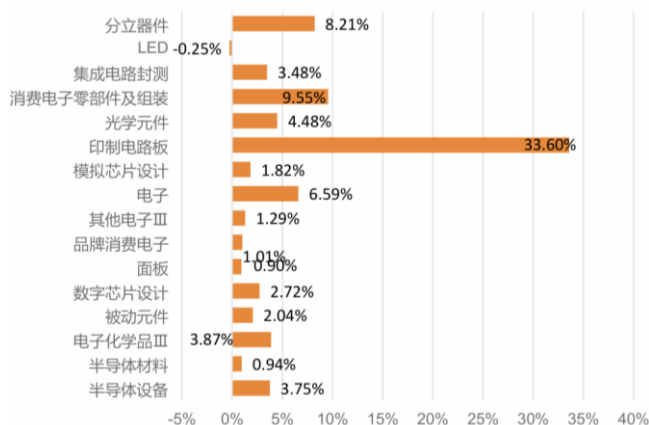


资料来源: iFinD, 天风证券研究所

2025 年 7 月, 申万指数各电子细分板块大部分上涨。涨幅居前三名分别为印制电路 (33.60%)、消费电子零部件及组装 (9.55%)、分立器件 (8.21%)。

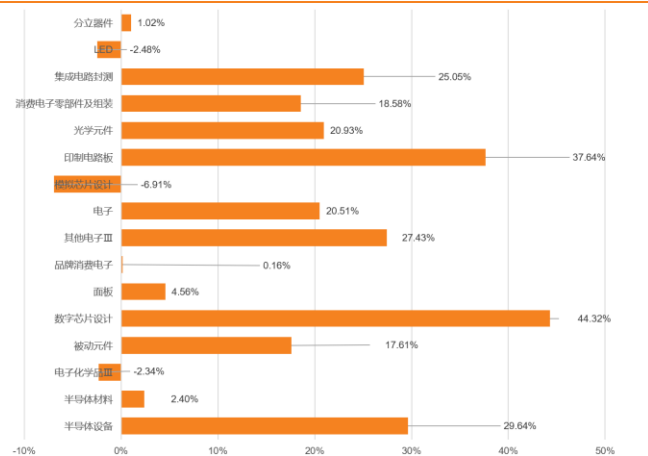
2024 年 1-12 月, 申万指数各电子细分板块大部分上涨。涨幅居前三名分别为数字芯片设计 (44.32%)、印制电路板 (37.64%)、半导体设备 (29.64%)。

图 9: 电子 (申万) 各板块涨跌幅 (2025 年 7 月)



资料来源: iFinD, 天风证券研究所

图 10: 电子 (申万) 各板块涨跌幅 (2024 年 1-12 月)

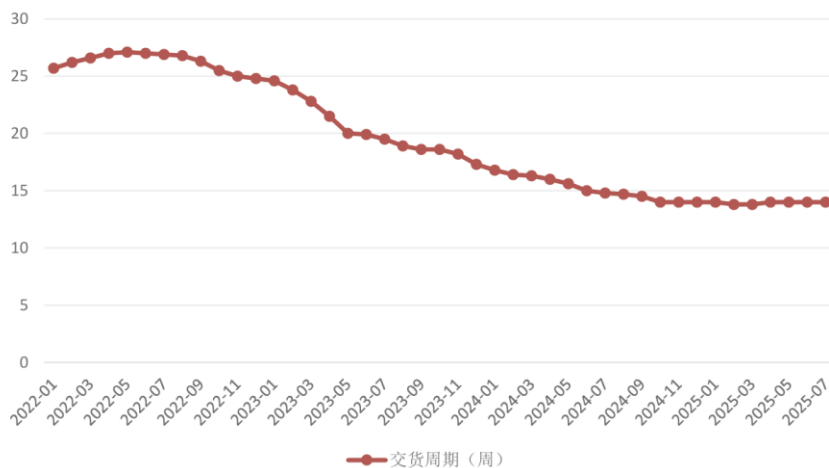


资料来源: iFinD, 天风证券研究所

3. 2025 年 7 月芯片交期及库存: 整体芯片交期趋稳

整体芯片交期趋势: 7 月, 元器件市场延续温和复苏走势, 交期相对稳定, 分化持续。

图 11: 全球芯片平均交货周期 (周)



资料来源：芯八哥公众号，Susquehanna Financial Group，天风证券研究所

重点芯片供应商交期：7月，主要芯片厂商交期有所上升，价格有较大波动。DDR4 为代表存储价格持续波动；模拟、功率、被动器件交期保持稳定，但部分价格有回升；MCU 交期稳定，车规 MCU 波动较大。展望 Q3，整体交期或有上升，价格延续稳定，分销环节订单持续改善。

表 1：头部厂商 2025 年 7 月交期及趋势

类别	供应商	产品	25.6 交期/周	25.7 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	8-24	16-24	稳定	根据市场调整
	BOSCH	传感器	6-12	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/电源	10-18	10-18	稳定	稳定
		开关稳压器	10-18	10-18	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	10-14	10-14	稳定	稳定
	Infineon	传感器	4-26	4-26	稳定	稳定
		开关稳压器	14-24	14-24	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	20-24	20-24	稳定	稳定
	ADI (Maxim)	放大器和数据转换器	12-20	12-20	稳定	稳定
		接口	20-26	20-26	稳定	稳定
		开关稳压器	10-14	10-14	稳定	稳定
	Microchip	放大器和数据转换器	4-10	4-10	稳定	稳定
		定时	7-12	7-12	稳定	稳定
		开关稳压器	8-20	8-20	稳定	稳定
	MPS	开关稳压器	12-24	12-24	稳定	稳定
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	16-20	16-20	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	16-20	16-20	稳定	稳定
	onsemi	传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		放大器和数据转换器	10-16	10-16	稳定	稳定
		定时	20-32	22-32	延长	稳定
		多源模拟/电源	10-18	10-18	稳定	稳定
		开关稳压器	10-20	10-20	稳定	稳定
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
	Renesas	放大器和数据转换器	12-18	12-18	稳定	稳定
		定时	12-24	12-24	稳定	稳定
		接口	14-18	14-18	稳定	稳定
		开关稳压器	14-24	14-26	缩短	稳定

	ROHM	传感器	24-52	24-52	稳定	上升
		开关稳压器	12-26	12-26	稳定	稳定
	ST	传感器	20-34	20-34	稳定	稳定
		放大器和数据转换器	10-16	10-16	稳定	下降
		多源模拟/电源	10-18	10-18	稳定	根据市场调整
		开关稳压器	10-20	10-20	稳定	下降
		汽车模拟和电源	16-18	16-18	稳定	稳定
	TE	传感器	16-52	16-52	稳定	根据市场调整
Vishay	传感器	24-52	24-52	稳定	稳定	
射频和无线	Infineon	蓝牙模块	16-24	16-24	稳定	稳定
	Microchip	WiFi 模块	12-20	12-20	稳定	下降
		蓝牙模块	12-20	12-20	稳定	下降
		收发器/接收器	12-20	12-20	稳定	稳定
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Larid	WiFi 模块	16-30	16-30	稳定	稳定
		天线	12-16	12-16	稳定	稳定
	ST	蓝牙模块	10-12	10-12	稳定	稳定
		收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
		RFID	20	10-12	稳定	稳定
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	稳定
		RFID	13	13	稳定	稳定
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	稳定
onsemi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定	
分立器件	Diodes	低压 MOSFET	10-24	12-40	延长	根据市场调整
		TVS 二极管	10-12	8	稳定	稳定
		桥式整流器	8-15	8-15	稳定	根据市场调整
		肖特基二极管	8-12	8-16	稳定	稳定
		整流器	8-13	8-13	稳定	根据市场调整
		开关二极管	8-12	8-16	稳定	稳定
		小信号 MOSFET	8-12	10-14	稳定	稳定
		齐纳二极管	8-12	8-16	稳定	稳定
		双极晶体管	8-12	8-16	稳定	稳定
		数字晶体管	8-12	8-16	稳定	稳定

		/RETS				
		通用晶体管	8-12	8-16	稳定	稳定
		逻辑器件	8-10	8-10	稳定	稳定
	Infineon	低压 MOSFET	10-22	8-39	延长	根据市场调整
		高压 MOSFET	8-20	9-26	延长	根据市场调整
		IGBT	12-42	10-42	延长	根据市场调整
		宽带隙 MOSFET	8-40	12-40	延长	根据市场调整
		数字晶体管 /RETS	6-30	10-14	稳定	稳定
		通用晶体管	10-30	10-14	稳定	稳定
		军用-航空晶体管	17-26	17-26	稳定	上升
		ST	低压 MOSFET	13-26	13-26	延长
	高压 MOSFET		13-26	13-26	延长	根据市场调整
	IGBT		14-20	14-26	延长	根据市场调整
	ESD		16-18	16-18	缩短	稳定
	宽带隙 MOSFET		22-45	30-45	稳定	根据市场调整
	晶闸管 / Triac		15-16	15-16	稳定	稳定
	TVS 二极管		16-18	12-14	稳定	稳定
	整流器		14-16	14-16	稳定	根据市场调整
	双极晶体管		12-24	16-30	延长	稳定
	Wingtech (Nexperia)	低压 MOSFET	6-14	8-20	延长	根据市场调整
		ESD	6-12	8-16	稳定	稳定
		肖特基二极管	6-12	8-16	稳定	稳定
		开关二极管	6-12	8-16	延长	稳定
		小信号 MOSFET	6-12	8-16	延长	稳定
		齐纳二极管	6-12	8-16	延长	稳定
		双极晶体管	6-12	8-16	延长	稳定
		数字晶体管 /RETS	6-12	8-16	延长	稳定
		通用晶体管	6-12	8-16	延长	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
	MCU	Renesas	8 位 MCU	12-18	14-18	稳定
32 位 MCU			12-18	14-18	稳定	稳定

		汽车	45	45	稳定	稳定
		32 位 MPU	12	12	稳定	稳定
	ST	8 位 MCU	10-24	10-24	延长	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MPU	10-16	13-16	延长	下降
	Infineon	8 位 MCU	10-26	10-26	稳定	稳定
		32 位 MCU	10-26	10-26	缩短	稳定
		汽车	32-54	32-54	稳定	稳定
	Microchip	8 位 MCU	4-12	4-12	稳定	稳定
		32 位 MCU	4-18	4-18	稳定	稳定
		32 位 MPU	4-20	4-20	稳定	稳定
	NXP	8 位 MCU	13-39	13-39	稳定	稳定
		32 位 MCU	13-39	13-39	稳定	稳定
		汽车	18-52	18-52	稳定	下降
		32 位 MPU	18-39	18-39	稳定	稳定
	可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	12-30	12-30	稳定
Intel (Altera)		14-30		14-30	稳定	稳定
Lattice		12-30		12-30	稳定	稳定
Microchip (Microsemi)		8-32		8-32	稳定	稳定
存储器	Infineon	SRAM	12-52	12-52	稳定	稳定
		NOR FLASH	12-26	12-26	稳定	根据市场调整
	GigaDevice	NOR FLASH	8-12	8-12	稳定	稳定
		NAND FLASH	6-10	6-10	稳定	稳定
	Samsung	DRAM (商用 PC)	-	-	-	-
		存储器模块	-	-	-	-
		eMMC	-	-	-	-
		固态驱动 (SSD)	-	-	-	-
	SK Hynix	NAND flash	6-10	6-10	稳定	稳定
		eMMC	8-12	12-30	延长	上升
被动元件	Murata	滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
		电感/变压器	12-20	12-20	稳定	稳定
		引线陶瓷电容	16-18	16-18	稳定	稳定
		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
	TDK	滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	稳定
		表面贴装通用陶瓷电容	24-30	24-30	稳定	稳定

		(车规级)		
--	--	-------	--	--

资料来源：芯八哥公众号，富昌电子，Wind，天风证券研究所

头部企业订单及库存情况：7月，汽车厂商订单增长不及预期，库存缓解但不确定性较高

图 12：头部厂商 2025 年 7 月订单及库存

公司	25.7订单	25.7库存	25.8订单预测	25.8库存预测
Intel	稳定	低	稳定	低
AMD	上升	低	上升	低
NVIDIA	上升	无	上升	无
Samsung	稳定	低	稳定	低
TI	稳定	较高	上升	一般
ST	下降	一般	下降	一般
ADI	稳定	一般	上升	一般
Qualcomm	上升	低	上升	低
Broadcom	稳定	低	稳定	一般
NXP	下降	一般	稳定	低
Infineon	下降	一般	稳定	较低
Renesas	下降	低	下降	一般
onsemi	下降	低	下降	低
Microchip	下降	一般	下降	一般
Micron	上升	低	上升	低
SK Hynix	上升	低	上升	低
Murata	上升	低	上升	低
MTK	上升	低	上升	低

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

4. 2025 年 7 月产业链各环节景气度：

4.1. 代工封测：代工订单持续复苏，封测订单增长良好

代工订单持续复苏，市场两极分化持续。

图 13：主要晶圆代工厂动态

厂商	25.7产能利用率	25.7动态	25.8订单预测
台积电	95%-100%	2nm良率优于预期,两年内逐步淘汰GaN代工	上升
三星	80%-90%	美国泰勒半导体工厂延后	稳定
联电	70%	获得高通HPC先进封装订单	稳定
中芯国际	85%-95%	14nm良率或超90%	上升
格芯	65%-75%	收购RISC-V架构厂商MIPS	稳定
世界先进	75%-80%	通讯、工业和汽车客户需求在回升	下降
力积电	60%-70%	下半年亏损压力较大	下降
华虹	> 100%	Fab9产能开始爬坡	上升

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

订单增长良好，日月光加速布局汽车和机器人市场。

图 14：主要封测厂商动态

厂商	25.7产能利用率	25.7动态	25.8月订单预测
日月光	75%-85%	赴美建厂在评估；布局汽车和机器人市场	上升
台积电	100%	AI及先进封装需求持续强劲	上升
长电科技	70%-85%	价格压力减轻	上升
通富微电	80%-90%	积极布局Chiplet、2D+等顶尖封装技术	上升
华天科技	80%-90%	直接出口到欧盟业务占比不大	上升
中小封测厂	60%-70%	订单稳定，价格压力较大	稳定

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

4.2. 设备材料零部件：国产自主可控预计进一步加速，设备厂商等 Q2 签单趋势向好

半导体设备增长稳定，材料厂商订单改善。

图 15：半导体设备及硅晶圆头部企业情况

类型	企业	25.7月订单	25.7月库存	25.8月订单预测
设备	ASML	稳定	低	稳定
	AMAT	稳定	低	上升
	泛林	上升	低	上升
	TEL	稳定	低	上升
	科磊	上升	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
	新凯来	上升	无	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	稳定
	Sumco (胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	稳定	一般	稳定

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

4.2.1. 设备及零部件中标情况：2025 年 7 月可统计中标设备数量共计 12 台

2025 年 7 月可统计中标设备数量共计 12 台。其中，薄膜沉积设备 2 台，辅助设备 4 台，检测设备 1 台，刻蚀设备 1 台，清洗设备 1 台，真空设备 3 台。

图 16：2025 年 7 月部分国内企业可统计中标情况（台）

求和项:设备台数	列标签	薄膜沉积设备	辅助设备	检测设备	刻蚀设备	清洗设备	热处理设备	总计
行标签								
北京北方华创微电子装备有限公司		2				1	3	6
东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司				1				1
广州长川科技有限公司			4					4
盛美半导体设备(上海)股份有限公司						1		1
总计		2	4	1	1	1	3	12

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2025 年 7 月，北方华创可统计中标设备 6 台，包括 2 台薄膜沉积设备，1 台刻蚀设备，3 台热处理设备

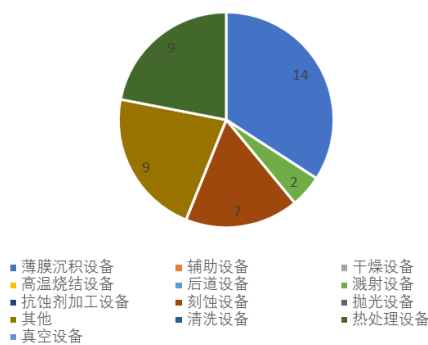
图 17：2020-2025.7 北方华创可统计中标情况（台）

行标签	计数项-设备台数	薄膜沉积设备	辅助设备	干燥设备	高温烧结设备	后道设备	溅射设备	抗蚀剂加工/刻蚀设备	抛光设备	其他	清洗设备	热处理设备	真空设备	总计	
2020年	19	2	2	2			3	6	20	6	2	9	13	5	87
2021年	24	1				3		3	1	35	9	9	11	15	111
2022年	15	5		4		1	3	2	49		13	8	9	6	115
2023年	18			3		7		34		10	8	13	4	97	
2024年	15			1		6		40	18	4	5	16	7	101	
2025年	9			4		14		10	10			14	5	51	
总计	100	8	2	11	4	29	3	192	6	62	39	76	30	582	

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 18：2025 年 1-6 月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

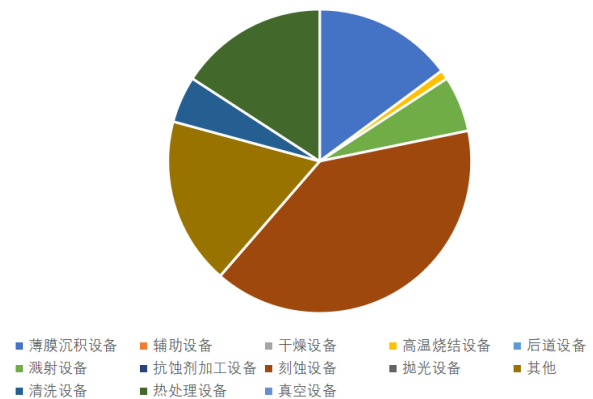
北方华创2025年各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 19：2024 年 1-12 月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

北方华创2024年各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2025 年 7 月，国内半导体零部件可统计中标共 7 项，主要为电气类 7 项。

图 20：2011-2025.7 国内半导体设备零部件可统计中标情况（台）

行标签	电气类	电镜类	机电一体类	机械类	气液/真空系统类	仪器仪表类	真空系统类(空白)	光学类	总计
2011年	2								2
第三季度	1								1
9月	1								1
11月	1								1
2012年	2								2
第一季度	2								2
2月	1								1
3月	1								1
2014年	1								1
第三季度	1								1
8月	1								1
2015年	7								7
第一季度	2								2
1月	2								2
2月	1								1
第二季度	2								2
3月	2								2
5月	1								1
第三季度	2								2
8月	2								2
2016年	4								4
第一季度	1								1
2月	1								1
第三季度	1								1
9月	1								1
第四季度	2								2
12月	2								2
2017年	3								3
第一季度	1								1
2月	1								1
第二季度	1								1
5月	1								1
第四季度	1								1
12月	1								1
2018年	7			1					8
第一季度	1			1					2
1月	1			1					2
2月	1								1
第二季度	2								2
4月	1								1
5月	1								1
第三季度	2								2
8月	2								2
第四季度	2								2
10月	1								1
12月	1								1
2019年	10					2			12
第一季度	1								1
2月	1								1
第二季度	1					1			2
5月	1					1			2
6月	1								1
第三季度	4					1			5
7月	4					1			5
9月	4								4
第四季度	4								4
10月	1								1
11月	1								1
12月	2								2
2020年	12			2		1		2	17
第一季度	2								2
2月	2								2
第三季度	7			2		1		1	11
7月	2			1					3
8月	4					1			5
9月	4								4
第四季度	4			1					5
10月	1								1
11月	1								1
12月	2								2
2021年	21			6		3			30
第一季度	2			1		1			4
1月	2			1					3
2月	2								2
3月	1					1			2
第二季度	5			1		1			7
4月	2			1					3
5月	3								3
第三季度	4			3		1			7
7月	3			2					5
9月	1			1					2
第四季度	10			1		1			12
10月	2								2
11月	1			1					2
12月	7					1			8
2022年	22		8	10		3			43
第一季度	7		1	1		2			11
1月	2								2
2月	2			1					3
3月	3		1	1		2			7
第二季度	6					1			7
4月	2								2
5月	2								2
6月	2					1			3
第三季度	5		1	5					11
7月	1			2					3
8月	1			1					2
9月	3			3					6
第四季度	4		6	4					14
10月	1			1					2
11月	3		3	2					8
12月	1		3	1					5
2023年	85		40	8		3	1		137
第一季度	10			5		1	1		17
1月	1			1					2
2月	1			2					3
3月	7			2		1	1		11
第二季度	9			1					10
4月	2								2
5月	2								2
6月	4			1					5
第三季度	20		21	2					43
7月	7			1					8
8月	8		15	1					23
9月	5		6	1					12
第四季度	46		19	3		2			67
10月	8		3			1			12
11月	11		12	3		1			24
12月	27		4	1					31
2024年	147	1	20	9		7	2	1	187
第一季度	27		2	2		3			34
1月	10			1		3			14
2月	9		1						10
3月	14		1	1					16
第二季度	32		12	1		2			47
4月	7		6						13
5月	11		6	1		1			19
6月	14		6	1		1			22
第三季度	41		2	1		2			46
7月	9			1					11
8月	12		1			1			14
9月	20								21
第四季度	47	1	4	5		2	1		60
10月	4		1	1					6
11月	14		3	3			1		21
12月	29		1	1					31
2025年	55		9	8		1	3		76
第一季度	19		3	2			3		27
1月	17		2				3		22
2月	2		1						3
第二季度	29		6	6		1			42
4月	7								7
5月	16		1	3					20
6月	6		5	2		1			14
第三季度	7								7
7月	7								7
总计	378	1	77	44		19	4	4	529

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2025年7月国外半导体零部件可统计中标共47项，主要为光学类40项。

图 21：2011-2025.7 国外半导体设备零部件可统计中标情况（台）

行标签	光学类	机电一体类	机械类	气液/真空系统	气液/真空系统	真空系统类 (空白)	总计
2011年						1	1
2012年						1	1
2013年						1	1
2014年						1	1
2015年						1	1
2016年						1	1
2017年						1	1
2018年						1	1
2019年						1	1
2020年						1	1
2021年						1	1
2022年						1	1
2023年						1	1
2024年						1	1
2025年						1	1
总计	4	2	1			19	21

行标签	光学类	气液/真空系统类	机电一体类	电气类	机械类 (空白)	气液/真空系统	真空系统类	仪器仪表类	总计
2021年	4	30	1	8	2				54
2022年	1	12		2					17
2023年	2	11	1						14
2024年	45	55	1	5	1				106
2025年	1	1							2
总计	52	397	10	52	55	1	15	2	1054

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为

4.2.2. 设备招标情况：2025年7月可统计招标设备1台

2025.7，华虹宏力公司可统计招标设备共1台，为离子注入设备。

2020-2025.7，公司可统计招标设备共4308台，包括269台薄膜沉积设备、806台辅助设备、57台光刻设备、73台后道设备、351台检测设备、2台溅射设备、35台抗蚀剂加工

设备、169 台刻蚀设备、39 台离子注入设备、53 台抛光设备、1685 台其他设备、159 台清洗设备、406 台热处理设备、204 台真空设备。

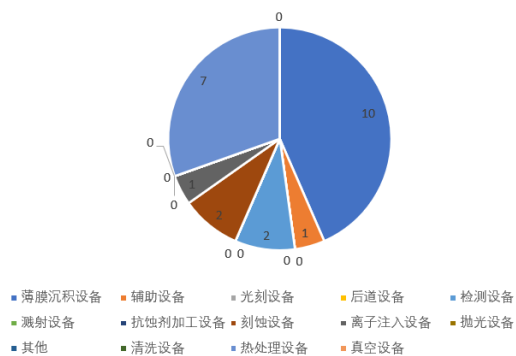
图 22：2020-2025.7 华虹宏力可统计招标情况（台）

行标签	薄膜沉积设备	辅助设备	光刻设备	后道设备	检测设备	测试设备	抗蚀剂加工设备	刻蚀设备	离子注入设备	抛光设备	其他	清洗设备	热处理设备	真空设备	总计	
2020年	122	90	20	5	147			6	56	20	20	1321	76	52	193	2128
2020年 第一季度	20	56	14		82			4	23	13	11	1289	35	42	147	1736
2020年 1月			2		3			2						1		8
2020年 2月		4	2		43			4			1270	10	22			1357
2020年 3月	20	52	10		36			19	13	11	19	25	19		147	371
2020年 第二季度	67	32	4		16			12	2	3	31	6			46	219
2020年 4月	56	32	3					2		3	30					172
2020年 5月	4							6				2				12
2020年 6月	7		1		16			4	2		1	4				35
2020年 第三季度	16		1	4	22			2	9	3	4	12	7			80
2020年 7月	5				10			6	1	2		3	5			32
2020年 8月	4			3	1			1				2	1			12
2020年 9月	7		1	1	11			2	2	2	1	7	1			36
2020年 第四季度	19	2	1	1	27			12	2	2	1	23	3			93
2020年 10月		2			3											6
2020年 11月	14		1	1	22			8	1	1	1	18				66
2020年 12月	5				2			4	1	1		5	3			21
2021年	101	240	10	26	16	2		5	62	12	17	173	38	248		950
2021年 第一季度	1	219			3			5		2			127			357
2021年 1月	1	217			1			2				1	126			348
2021年 2月		2											1			3
2021年 3月					2			3			1		4	8		30
2021年 第二季度			1	8	5			3	1							10
2021年 4月					3			3						3		6
2021年 5月				2	1											4
2021年 6月			1	6	1				1				4	1		14
2021年 第三季度	7	21	1	8	8			1		2	171	3				222
2021年 7月	5	21	1	4	6					1	170	3				211
2021年 8月	1			4	2			1								8
2021年 9月	1										1	1				3
2021年 第四季度	93		8	10		2		5	53	11	15		31	113		341
2021年 10月	1					2							1			5
2021年 11月													2			2
2021年 12月	92		7	10				5	53	11	15		28	113		334
2022年	13	52	5	10	106		2	20	1	1	11	9	57			287
2022年 第一季度	5	11	3	6	81		1	9		1	1	6	3			127
2022年 1月		3	2	3	75			1				4				88
2022年 2月	1	6						1								8
2022年 3月	4	2	1	3	6			8			1	1	2	3		31
2022年 第二季度	3	38			1			1				1		42		86
2022年 4月	1				1			1				1		34		38
2022年 5月	2	38												8		48
2022年 第三季度	4				6			4			9	2	5			30
2022年 7月	2							2								4
2022年 8月	1				2			2								6
2022年 9月	1				4						8	2	5			20
2022年 第四季度	1	3	2	4	18			1	6	1	1		7			44
2022年 10月					1											1
2022年 11月			1		1			1		1						5
2022年 12月	1	3	1	4	16			6					31			38
2023年	10	13	21	28	35		21	14		7	17	16	7	11		224
2023年 第一季度	6	10			1			3			14	1	4	11		50
2023年 1月	5	1			1			3				1	4			16
2023年 2月	1	3										13				11
2023年 3月		6														6
2023年 第二季度								6				1				7
2023年 4月																1
2023年 5月								6								6
2023年 第三季度	4	3	21	28	32		21	4		6	2	2	26			149
2023年 7月	4	3	21	27	31		21	2		6	1	20				136
2023年 8月								2				1	6			9
2023年 9月				1	1						2					4
2023年 第四季度					2			1				13	1			18
2023年 10月					1							13				14
2023年 11月								1								3
2023年 12月					1											1
2024年	13	410	1	4	45		1	15	4	8	163	20	11			695
2024年 第一季度	13	54	1	4	38		1	15	3	8	2	19	10			168
2024年 1月		52			10			1				7				70
2024年 2月	13	2	1	4	28		1	14	3	8	2	12	10			98
2024年 第二季度		356			7				1			1	1			366
2024年 3月																1
2024年 4月																1
2024年 5月		309			5				1				1			316
2024年 6月		47			2											49
2024年 第三季度											60					60
2024年 7月											60					60
2024年 第四季度											101					101
2024年 10月											100					100
2024年 11月											1					1
2025年	10	1			2			2	2				7			24
2025年 第一季度	10	1			2			2	1				7			23
2025年 2月	5	1						1					2			9
2025年 3月	5				2			1		1			4			13
2025年 4月													1			1
2025年 5月																1
2025年 6月																1
2025年 7月																1
总计	269	806	57	73	351	2	35	169	39	53	1685	159	406	204		4308

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 23：2025 年 1-6 月华虹宏力各主要设备类型招标分布情况（台）

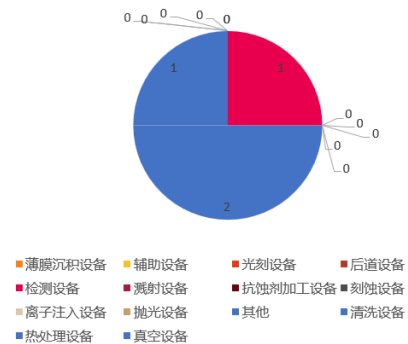
华虹宏力2025年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 24：2024 年 1-12 月华虹宏力各主要设备类型招标分布情况（台）

华虹宏力2024年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

4.3. 分销商：2025 年中国分销市场预期乐观，关注日系分销商加大在中国半导体市场采购和布局

分销市场整合频繁，文晔与日电贸达成换股合作。

图 25：主要元器件分销商最新动态

厂商	25 年 7 月动态
艾睿	印度设立工程设计解决方案中心
大联大	AI 需求下上半年营收同比增长 28%，创历年新高
文晔科技	与日电贸达成换股合作，扩大被动市场布局；看好 Q3 市场需求
Smith	onsemi、Diodes 及 NXP 的 MOSFET、BJT 需求旺盛
Macnica	增加与中国半导体企业合作，聚焦中国及亚洲市场 AI 服务器等客户需求增加
中电港	AI 服务器等客户需求增加
深圳华强	获得昇腾 APN“金牌部件伙伴”授牌；海思产品线收入增长显著
香农芯创	企业级 SSD 订单需求良好
英唐智控	分销产品毛利均存在压缩，与市场毛利趋势保持一致
力源信息	订单保持稳定
雅创电子	HBM 产品尚未形成销售额
商络电子	eVTOL 产品研发周期与适航情况尚存不确定性

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5. 7 月终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势

5.1. 消费电子：无人机商业化应用加速，传音拟非洲等布局电动两轮车业务

图 26：消费电子厂商最新动态

类别	企业	7 月动态
智能手机	苹果	Q2 中国市场智能手机出货量高于预期；iPhone 累计出货超 30 亿台
	三星	下半年加码 AI 在智能设备端的集成
	华为	鸿蒙版微信安装量破千万；Q2 智能手机出货量时隔四年重返中国第一
	荣耀	Q2 中国市场表现全面恢复
	小米	中国市场手机出货量连续八个季度保持同比增长
PC	传音	增加对非洲等市场布局
	联想	Q2 全球 PC 出货量第一
	惠普	企业需求均保持稳定
	苹果	MacBook 销量持续稳健
VR/AR	戴尔	小型 OEM/ODM 商激价格竞争压力增加
	Meta	Q2 VR 业务线亏损 45.3 亿美元
	小米	AI 眼镜目标三年内年出货量超 500 万台
	Pico	消费端产品增长乏力
无人机	Rokid	截止 5 月公司智能眼镜累计销量达 30 万台
	阿里巴巴	推出 WOW AI+AR 眼镜
	大疆	测绘市场需求持续增长
	极飞科技	在巴西建立农业无人机工厂
电动两轮车	纵横股份	与沙特阿美合作开发油气巡检专用机型
	美团	深圳试点无人机配送网络，日均配送量突破 10 万单
	九号	国补影响下 3000 元以上价格份额在不断扩容
	雅迪	订单快速增长
	小牛	NXT 系列订单持续增长
	爱玛	深化印尼越南本地化运营并开拓欧美市场
	传音	在非洲等发展中国家探索两轮电动车相关业务

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.2. 新能源汽车：特斯拉销量下滑明显，市场竞争加剧

图 27：新能源汽车厂商最新动态

厂商	7月动态
比亚迪	2026年起在巴基斯坦组装电车;将开始在巴西组装电动汽车
特斯拉	Q2营收净利双双下跌,销量下滑加剧
本田	推迟在日本生产燃料电池计划
大众	Q2欧洲电车销售快速增长,中国市场销售32.6%
宝马	欧洲市场需求上升,中国市场下滑
奔驰	关税影响下Q2全球交付量下滑9%
丰田	计划今年在印尼启动电车生产
福特	将推出一系列平价电动汽车
Stellantis	预计上半年亏损27亿美元
通用	Q2因关税损失11亿美元
现代	将引入中国更多新能源车型
上汽	前7个月海外市场累计销售57.6万辆,同比增长1.1%
雷诺	下调盈利预期
广汽埃安	总计14096支直流快充桩位居车企自建快充榜第一
长安	计划在欧洲建厂
吉利	涉及3000人的智驾团队正在进行调整
奇瑞	与华为合作投资超100亿元拓展新能源汽车市场
理想	i8上市售价下调
零跑	7月销量首破5万登顶
小米	7月交付量超3万辆,再创新高
赛力斯	1-7月累计销量约为21.67万辆,同比下降10.87%
蔚来	智驾大模型迭代团队扩至3200人
小鹏	上半年海外累计销量突破1.8万台,同比增长217%

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

5.3. 工控：数据中心和电气化相关订单增长强劲，欧洲工业市场需求相对疲软

图 28：工控厂商最新动态

厂商	7月动态
西门子	数据中心和能源客户订单强劲
ABB	1.3亿加元在加拿大建先进制造与研发基地
霍尼韦尔	欧洲工业市场需求疲软;完成战略性补强收购Li-ion Tamer
施耐德电气	Q2营收同比增长8%;北美、印度和中东订单增长良好
汇川技术	匈牙利(电梯)和泰国工厂(新能源汽车)投入运营,加速海外布局
埃斯顿	下游市场需求回暖及国产替代进程加速
英威腾	在中东地区有开展储能及电源相关业务
麦格米特	高功率人工智能数据中心电源产品潜力巨大
华中数控	新能源汽车等领域高端数控产品需求激增
雷赛智能	OEM自动化市场规模超过1000亿元

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

5.4. 光伏：头部厂商上半年亏损明显，预计今年全球光伏需求保持稳定，但增速有所放缓

图 29：光伏厂商最新动态

厂商	7月动态
隆基绿能	维持全年组件出货80-90GW目标,全球光伏需求增速从2025年开始放缓
天合光能	与Solaris Energy达成光伏组件供应协议
通威股份	预计2025H1净亏损约49-52亿元
晶科能源	明年预期绝大部分订单将切换为640W以上高功率产品;Q3排产环比稳定
晶澳科技	组件价格根据市场阶段性供需、供应链采购等产生波动
阿特斯	今年光伏需求预计继续增长,但增速放缓
东方日升	上半年光伏组件中标量位列行业第六
爱旭股份	业绩超预期扭亏,但下半年仍有不确定性
横店东磁	海内外优质市场出货量持续提升
协鑫集成	预计2025H1净利润亏损约2.5-3.5亿元
钧达股份	2025H1归母净利润亏损2-3亿元,受供需错配、价格下行影响

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

5.5. 储能：储能订单增长预期良好，国内厂商加速海外市场布局

图 30：存储厂商最新动态

厂商	7月动态
Fluence	与澳大利亚能源巨头AGLEnergy签订500MW/2000MWh储能合作协议，是目前全球最大的电池储能系统协议之一
阳光电源	储能订单充足
宁德时代	市场需求依然比较旺盛
特斯拉	美国10GWh的磷酸铁锂电池工厂预计年底投产
阿特斯	拥有约91GWh储能系统订单储备
盛弘股份	海外储能业务拓展符合预期
亿纬锂能	拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地
派能科技	持续拓展海外新兴市场
上能电气	储能订单需求呈现高速增长态势
天合光能	2025年海外储能订单近2.5GWh，主要分布在欧洲和亚太地区

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.6. 数据中心：云计算厂商投入持续，上游服务器订单增长强劲

图 31：数据中心厂商最新动态

企业	7月动态
OpenAI	推出最新人工智能模型GPT-5
亚马逊	云计算部门开启部分裁员;上海AI研究院正式解散
微软	新一代AI芯片Braga量产从2025年推迟至2026年
Meta	计划2026年启用Prometheus1GW超级集群
苹果	将在全美各地建立数据中心;计划自研数据中心AI芯片
谷歌	未来两年将在美投资250亿美元用于数据中心建设
阿里巴巴	计划扩大泰国、墨西哥及韩国的AI基础设施投资
戴尔	AI服务器需求持续增长
华为	传计划重新设计AI芯片，转向GPGPU
联想	加大混合式人工智能投入
浪潮	发布万亿参数大模型的超节点AI服务器

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.7. 通信：传统网络通信业务仍疲软，数据中心相关订单强劲

图 32：通信厂商最新动态

企业	7月动态
AT&T	拟以超20亿美元出售墨西哥移动部门;加速光纤网络扩张
VodafoneThree	今年将投入13亿英镑加速网络整合和升级
Verizon	扩大光纤资产投入，面临同行竞争压力导致市场份额被蚕食
T-Mobile	预计年底前将新增数十万用户;光纤业务尚处起步阶段
中国移动	全年计划资本开支不超1512亿元，占比将继续下降
中国联通	8.7万台服务器集采需求国产化率超90%
中国电信	加速AI布局，已打造10余款AI标准化产品
中兴通讯	持续投入6G各关键技术领域研发，布局手机直连卫星等前沿技术
思科	数据中心交换机订单强劲增长
爱立信	网络销售增长不及预期，5G网络设备市场仍较为脆弱
诺基亚	光网络业务订单延续强劲;预计今年基础网络业务稳健增长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.8. 医疗器械：头部厂商中国市场订单低迷，Q3 或迎来拐点

巨头加速中国本土化布局，AI 应用持续增长

图 33：医疗器械厂商最新动态

企业	7月动态
强生	全年预计销售额上调至934亿美元，增长动力充足
美敦力	美国、欧洲、中东和非洲地区增长强劲;AI医疗设备授权领先
波士顿科学	预计今年的关税费用将降低约1亿美元;看好中国市场业务增长
飞利浦	中国市场订单下降
雅培	全年业绩可期，原因在于医疗设备等业务持续扩张
西门子医疗	影像业务订单增长显著
GE医疗	2025H1中国区营收11.56亿美元，同比下滑2%
迈瑞医疗	03中国市场开始迎来重大拐点;发展中国家全年有望维持快速增长
鱼跃医疗	加速布局AI在医疗设备领域应用
联影医疗	海外市场订单业绩持续改善

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

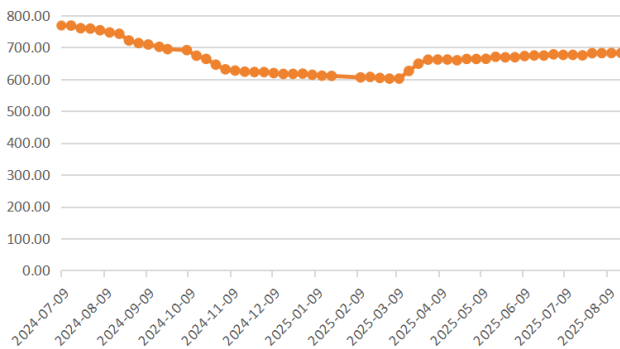
6. 存储行情：本周存储现货市场以持稳为主，行业 DDR4 内存条与 LPDDR4X 产品高位盘整

时间来到三季度中旬，通用型 DRAM 现货市场渐趋回归平静，行业 DDR4 内存条和 LPDDR4X 均高位盘整；嵌入式 eMMC 产品因部分客户备货积极性不高，市场活跃度有限；行业和渠道 SSD 短期则维持稳定。

尽管行业 DDR4 内存条不及渠道市场反应迅速，但 3 月以来累计涨幅也接近一倍，行业 DDR4 内存条和 DDR5 之间已然出现倒挂，部分 PC OEM 厂商为降低成本压力选择价格更低的 DDR4 次级资源作为替代，不过也有些客户尚在评估和观望阶段。未来，在 DDR4 供应有限且 PC 客户库存持续消耗下，将加速 DDR5 内存条应用进一步普及，而基于成本考虑 PC 厂商针对个别产品线或继续沿用 DDR4 降级资源。

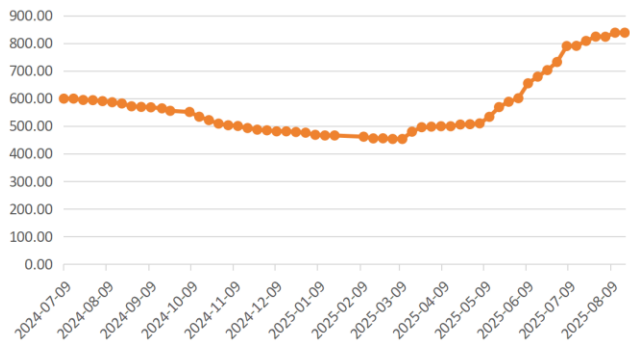
7 月底以来，存储原厂相继进入财报密集披露期，从业绩数据上看，SK 海力士营收和营业利润双创新高；而唯一一家处于亏损状态的闪迪二季度也成功扭亏为盈；三星、SK 海力士、闪迪等原厂 Q2 出货量明显增长，库存水平也有所降低。展望未来，DRAM 原厂的供应将更多侧重于 DDR5、LPDDR5X 和 HBM 等尖端产品，而 NAND 方面则加速向先进节点进一步迁移。

图 34：NAND 指数



资料来源：闪存市场，天风证券研究所

图 35：DRAM 指数



资料来源：闪存市场，天风证券研究所

上游资源方面，本周 Flash Wafer、DDR4、DDR5 颗粒价格维持不变。

图 36: Flash Wafer 8.19 报价 (美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
1Tb QLC	5.00	5.00	0.00%
			0.00
1Tb TLC	5.60	5.60	0.00%
			0.00
512Gb TLC	3.05	3.05	0.00%
			0.00
256Gb TLC	2.85	2.85	0.00%
			0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

图 37: DDR 8.19 报价 (美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 16Gb 3200	6.40	6.40	0.00%
			0.00
DDR4 16Gb eTT	4.00	4.00	0.00%
			0.00
DDR4 8Gb 3200	3.20	3.20	0.00%
			0.00
DDR4 8Gb eTT	2.20	2.20	0.00%
			0.00
DDR4 4Gb eTT	0.70	0.70	0.00%
			0.00
DDR5 24Gb Major	7.75	7.75	0.00%
			0.00
DDR5 16Gb Major	4.80	4.80	0.00%
			0.00
DDR5 16Gb eTT	4.10	4.10	0.00%
			0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

近期渠道 DDR5 内存条受基板交期影响, 成品出货周期有所延长, DDR5 内存条价格呈现微幅上扬趋势, 但涨幅较小基本可忽略; 渠道 DDR4 内存条和 SSD 也保持平稳。因此本周渠道内存条和 SSD 价格维持上周水平。

图 38: 渠道市场 SSD 8.19 报价 (美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 120GB SATA3	6.80	6.80	0.00%
			0.00
SSD 240GB SATA3	9.80	9.80	0.00%
			0.00
SSD 480GB SATA3	19.50	19.50	0.00%
			0.00
SSD 256GB PCIe 3.0	13.40	13.40	0.00%
			0.00
SSD 512GB PCIe 3.0	22.00	22.00	0.00%
			0.00
SSD 1TB PCIe 3.0	41.60	41.60	0.00%
			0.00
SSD 512GB PCIe 4.0	26.00	26.00	0.00%
			0.00
SSD 1TB PCIe 4.0	45.00	45.00	0.00%
			0.00
SSD 2TB PCIe 4.0	83.00	83.00	0.00%
			0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

图 39: 渠道市场内存条 8.19 报价 (美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 UDIMM 8GB 3200	14.00	14.00	0.00%
			0.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200	26.00	26.00	0.00%
			0.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200	57.00	57.00	0.00%
			0.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600	32.00	32.00	0.00%
			0.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000	35.00	35.00	0.00%
			0.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600	65.00	65.00	0.00%
			0.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000	67.00	67.00	0.00%
			0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

本季度时间已然过半, 行业厂商逐步推动 PC 客户新季度的价格谈判进程, 但面对存储厂商仍然咬住价格的坚定态度, 部分 PC OEM 却期盼争取更低的价格成交, 买卖双方仍处于持续拉锯阶段。内存条方面, 在 4 月原厂相继宣布停产通用型 DDR4 产品以来, 行业厂商近一个季度 DDR4 高规格颗粒采购量少之甚少, 面对主要 PC OEM 客户考虑增加 DDR4 内存条备货的需求, 行业厂商表示实难分配供货。对于 PC 厂商来说, 虽当前备有一定库存尚能维持短期正常生产, 但明年上半年 DDR4 供应压力将明显传导至 PC 终端。

图 40: 行业市场 SSD 7.22 报价 (美元)

图 41: 行业市场内存条 7.22 报价 (美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 256GB SATA3	18.50	18.50	0.00%
			0.00
SSD 512GB SATA3	29.50	29.50	0.00%
			0.00
SSD 1TB SATA3	55.00	55.00	0.00%
			0.00
SSD 256GB PCIe 3.0	20.50	20.50	0.00%
			0.00
SSD 512GB PCIe 3.0	32.00	32.00	0.00%
			0.00
SSD 1TB PCIe 3.0	56.00	56.00	0.00%
			0.00
SSD 512GB PCIe 4.0	34.00	34.00	0.00%
			0.00
SSD 1TB PCIe 4.0	59.00	59.00	0.00%
			0.00
SSD 2TB PCIe 4.0	110.00	110.00	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 SODIMM 4GB 3200	14.00	14.00	0.00%
			0.00
DDR4 SODIMM 8GB 3200	24.00	24.00	0.00%
			0.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200	45.00	45.00	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

自去年年底 MLC NAND 启动涨价潮以来，经过半年多的上涨行情，MLC NAND 价格逐渐向 256Gb TLC NAND 靠拢，甚至 128Gb MLC NAND 价格已超过部分 512Gb TLC NAND。存储厂商也同步调涨低容量嵌入式成品售价，使得 64GB 及以下容量 eMMC 产品几乎同价。而高昂的硬件成本压力已渐渐反噬至部分应用市场，尤其是本就单价低、利润微薄的消费类产品。一方面，应用需求将加速向 64GB 及以上容量的嵌入式产品转移，另一方面，存储厂商或将采用较高容量的 NAND，通过固件或设计限制对其进行降容处理，短期规避低容量 eMMC 产品供应风险。

图 42：eMMC 8.18 报价（美元）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMMC 8GB 5.1	3.20	3.20	0.00%
			0.00
eMMC 16GB 5.1	3.80	3.80	0.00%
			0.00
eMMC 32GB 5.1	4.00	4.00	0.00%
			0.00
eMMC 64GB 5.1	4.00	4.00	0.00%
			0.00
eMMC 128GB 5.1	7.20	7.20	0.00%
			0.00
eMMC 256GB 5.1	14.00	14.00	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 43：eMCP 8.18 报价（美元）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 64GB +32Gb	14.50	14.50	0.00%
			0.00
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 128GB B+32Gb	18.50	18.50	0.00%
			0.00
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 128GB B+48Gb	24.50	24.50	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 44：LPDDR 8.19 报价（美元）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
LPDDR4X 96Gb	32.00	32.00	0.00%
			0.00
LPDDR4X 64Gb	25.00	25.00	0.00%
			0.00
LPDDR4X 48Gb	20.50	20.50	0.00%
			0.00
LPDDR4X 32Gb	14.20	14.20	0.00%
			0.00
LPDDR4X 16Gb	8.00	8.00	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 45：UFS 8.19 报价（美元）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
UFS 2.2 64GB	4.80	4.80	0.00%
			0.00
UFS 2.2 128GB	7.50	7.50	0.00%
			0.00
UFS 2.2 256GB	14.50	14.50	0.00%
			0.00
UFS 2.2 512GB	28.00	28.00	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 46: uMCP8.19 报价 (美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
uMCP (LPDDR4X+UFS 2.2) 4GB+128GB	19.50	19.50	0.00%
uMCP (LPDDR4X+UFS 2.2) 6GB+128GB	25.00	25.00	0.00%
uMCP (LPDDR4X+UFS 2.2) 8GB+128GB	29.00	29.00	0.00%
uMCP (LPDDR4X+UFS 2.2) 8GB+256GB	39.00	39.00	0.00%

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

7. 上周 (08/18-08/22) 半导体行情回顾

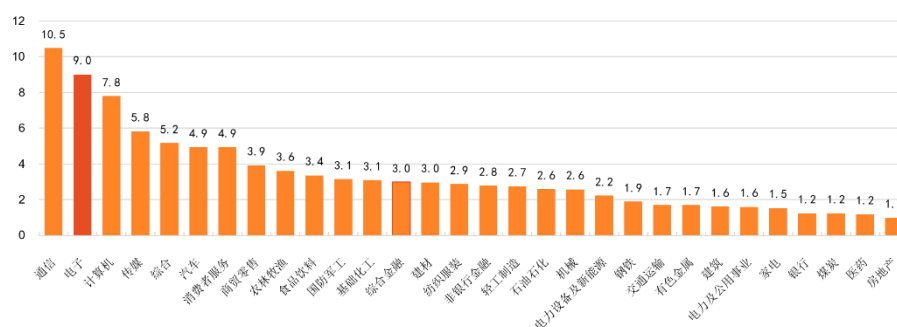
上周 (08/18-08/22) 半导体行情跑赢主要指数。上周创业板指数上涨 5.85%，上证综指上涨 3.49%，深证综指上涨 4.57%，中小板指上涨 4.46%，万得全 A 上涨 3.87%，申万半导体行业指数上涨 12.26%。

表 2: 上周半导体行情与主要指数对比

	上周涨跌幅 (%)	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	5.85	6.40
上证综合指数	3.49	8.77
深证综合指数	4.57	7.69
中小板指数	4.46	7.62
万得全 A	3.87	8.38
半导体 (申万)	12.26	-

资料来源: Wind, 天风证券研究所

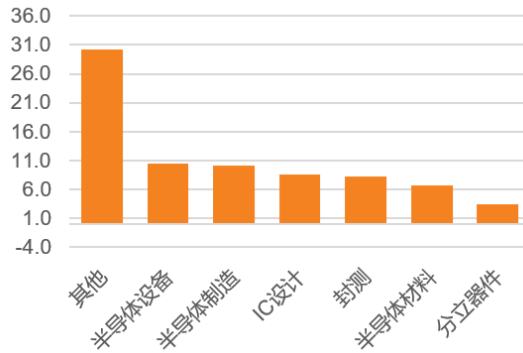
图 47: 上周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

半导体各细分板块均上涨, 其他板块涨幅最大。半导体细分板块中, 封测板块上周上涨 8.2%, 半导体材料板块上周上涨 6.7%, 分立器件板块上周上涨 3.4%, IC 设计板块上周上涨 8.7%, 半导体设备板块上周上涨 10.5%, 半导体制造板块上周上涨 10.1%, 其他板块上周上涨 30.2%。

图 48: 上周子板块涨跌幅 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

8. 上周（08/18-08/22）重点公司公告

【688699.SH】明微电子

2025年8月22日，公司发布深圳市明微电子股份有限公司股东询价转让计划书的公告。拟参与深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“明微电子”、“公司”）首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为深圳市明微技术有限公司（以下简称“明微技术”、“出让方”）；出让方拟转让股份的总数为6,228,432股，占明微电子总股本的比例为5.66%；本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

【300782.SZ】卓胜微

2025年8月22日，公司发布关于向2025年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的公告。江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年8月21日为限制性股票授予日，以35.58元/股的授予价格向符合授予条件的336名激励对象授予278.3280万股限制性股票。

9. 上周（08/18-08/22）半导体重点新闻

英伟达 CEO 黄仁勋突现中国台湾地区：拜访台积电，Rubin 架构有 6 款全新芯片。 IT之家 8 月 22 日消息，据雅虎财经报道，英伟达 CEO 黄仁勋今日无预警突然现身中国台湾地区，他受访时直言，此行最主要的目的就是要拜访台积电，亲自感谢对方在下一代芯片架构「Rubin」上的全力协助，并表示今晚就要离开。黄仁勋表示：“我们的下一代架构叫作 Rubin，这是一个非常先进的架构，目前我们已经在台积电完成六款全新芯片的投产，包括新的 CPU、新 GPU、全新升级的 NVLink 交换器、新网络芯片、新网络交换器，以及我们的矽光子处理器。这些芯片现在都在台积电的厂里，我此行就是来感谢他们，感谢所有台积电的营运团队这么辛苦替我工作。”谈到外界盛传的 H20 芯片出货状况，黄仁勋也回应：“我们已经澄清过，H20 没有后门，从来没有过这样的问题。”至于即将于 10 月首次在美国华盛顿举办的 GTC 大会，黄仁勋透露，将聚焦 AI 在各个科学领域的应用，“不只是聊天机器人，未来还会有量子 AI、电信 AI、物理 AI、化学 AI、材料科学 AI 等，我会在华盛顿谈这些，以及英伟达 AI 如何影响美国的产业伙伴。”谈到此行是否有紧急议题需要和台积电处理，黄仁勋语气轻松地说：“没有，台积电做得非常好。我只是想和他们的领导人共进晚餐，亲自表达感谢。有时候公司之间会觉得对方理所当然，但即使台积电

不需要我们的感谢，他们仍然会做到最好。不过，能对他们说声谢谢，还是很重要的。”IT之家注意到，这是黄仁勋今年第三次来到中国台湾地区，年初参加中国台湾地区分公司尾牙，5月参加2025台北电脑展并发表专题演讲。

同步欧元区，英伟达在英国降低 RTX 5090 / 5080 / 5070 显卡建议零售价。IT之家8月22日消息，参考英国媒体OC3D的报道，英伟达在英国市场对部分 GeForce RTX 50 系列游戏显卡的建议零售价 (MSRP) 进行了下调。此次定价出现变动的型号与近期欧元区降价款式相同，即 RTX 5090 / RTX 5080 / RTX 5070，整体降幅在 7+%。与这三款同期发布的 RTX 5070 Ti 和更晚推出的 RTX 5060 Ti (均无公版) 没有建议零售价变化。另据英媒的说法，GeForce RTX 5070 显卡在当地的实际交易价格已降至 460 英镑 (IT之家注：现汇率约合 4437 元人民币) 左右，较新 MSRP 还低出不少。

10. 风险提示

地缘政治带来的不可预测风险：随着地缘政治冲突加剧，美国等国家/地区相继收紧针对半导体行业的出口管制政策，国际出口管制态势趋严，经济全球化受到较大挑战，对全球半导体市场和芯片供应链稳定带来不确定风险。未来如美国或其他国家/地区与中国的贸易摩擦升级，限制进出口及投资，提高关税或设置其他贸易壁垒，半导体行业相关公司还可能面临相关受管制设备、原材料、零备件、软件及服务支持等生产资料供应紧张、融资受限的风险等，进而对行业内公司的研发、生产、经营、业务造成不利影响。

需求复苏不及预期：受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业存在一定的周期性，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响。另外，下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求。

技术迭代不及预期：集成电路行业属于技术密集型行业，集成电路涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来，集成电路行业公司坚持自主研发的道路并进一步巩固自主化核心知识产权。如果行业内公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级的需要，可能导致公司技术被赶超或替代，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

产业政策变化风险：集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。国家陆续出台了包括《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面为集成电路企业提供了更多的支持。未来如果国家相关产业政策出现重大不利变化，将对行业发展产生一定不利影响。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com